



DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies



研削磨輪

GS08系列 Grinding Wheels

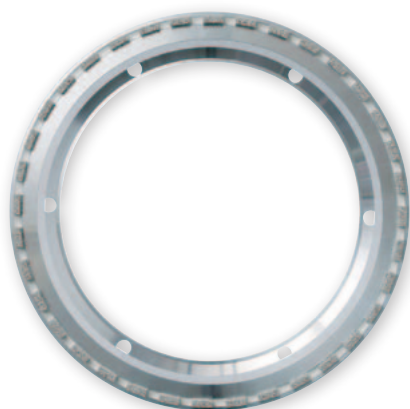
實現高品質 SiC 晶圓研磨的研磨輪



採用多孔陶瓷結合劑固定磨粒，以實現高品質的SiC晶圓研磨

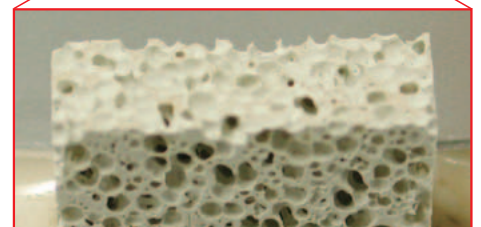
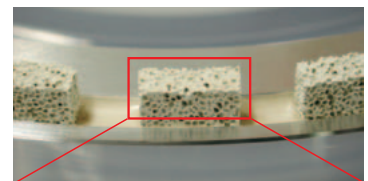
GS08系列研磨輪，是針對高硬度的SiC晶圓研磨，採用磨屑排出能力與研磨水供給能力皆優的新開發多孔陶瓷結合劑固定磨粒，以研磨加工實現接近於拋光的表面粗糙度。可對貼附於膠膜上的晶片進行研磨，因不需將蠟貼附至基板（或自基板剝除），實現比研磨漿製程（Slurry Process）簡單的操作程序。

- 以固定磨粒研磨，實現接近拋光的表面粗糙度
- 可對貼附於膠膜上的晶片進行研磨，製程較簡單
- 不需研磨漿（Slurry）的製程，可減輕環境負荷



■ 多孔陶瓷結合劑

GS08系列採用原創新開發的多孔陶瓷結合劑。



加工對象 碳化矽（SiC）、氧化鋁陶瓷、氮化矽、其他材料

GS08系列 Grinding Wheels

(mm)			
研削磨輪直徑	研削齒表示符號	研削齒形狀	研削齒排列
200	SR	齒狀	正圓形

GS08 - SE0126 200 × 3.5 W × 4.5 T - SR

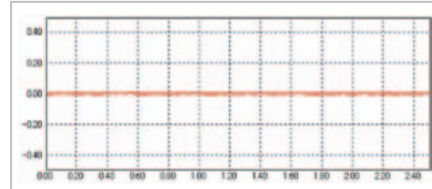
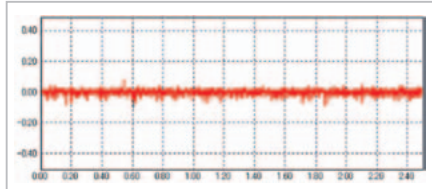
研削齒品種	研削齒寬度	研削齒高度
SE0126 標準型	3.5	4.5
SA0135 細網型	3.5	3.5

(mm) (mm)



實驗結果

■SiC研磨時的表面粗糙度



使用磨輪	SE0126 (標準型)	SA0135 (細網型)
Ra (μm)	0.011	0.001
Ry (μm)	0.115	0.009

工作物 : φ3" SiC晶圓
測量儀器 : 接觸式表面粗糙度測量儀

本公司的所有產品都已加入產品賠償責任保險。

下訂單時

在下訂單時，請用戶將產品的類型名稱、外徑、研削磨輪直徑及數量通知本公司，另外在初次訂購時，本公司銷售窗口會根據不同加工要求，協助用戶選擇最適合的產品，屆時請一併提供研削材料、尺寸、形狀、所用設備(裝置)及其他相關加工條件等資料。

為了改進產品，本公司可能在未通知用戶的情況下，就對產品規格進行變更，因此請仔細核對規格後再下訂單。



為了安全使用本公司的各種產品

為了預防發生因研削磨輪、切割刀片(以下通稱精密加工工具)的破損而造成的各種事故和人身傷害，請嚴格遵守下列各注意事項。

- 請使用安全擋板(包括噴嘴外殼或外蓋)。
- 在使用注有限制旋轉數的精密加工工具時，請不要超出其規定的旋轉數範圍。
- 在安裝精密加工工具時，請遵照設備(裝置)使用說明書的規定，正確地進行安裝。
- 請不要使精密加工工具掉落在地上，或發生碰撞。
- 在每次使用精密加工工具前必須先進行檢查，如果有缺口或其他破損，請停止使用。
- 在開始使用前，請先仔細閱讀相關設備(裝置)的使用說明書。
- 請不要使用經過改裝的設備(裝置)。
- 請不要使用不符合設備(裝置)指定尺寸的精密加工工具。
- 除了研削、切割及切削作業以外，請不要使用在其他用途。
- 在使用濕式研削、切割用精密加工工具時，請使用冷卻液。



DISCO CORPORATION

東京都大田區大森北2-13-11 〒143-8580

Phone: 03-4590-1100 Fax: 03-4590-1075 www.disco.co.jp